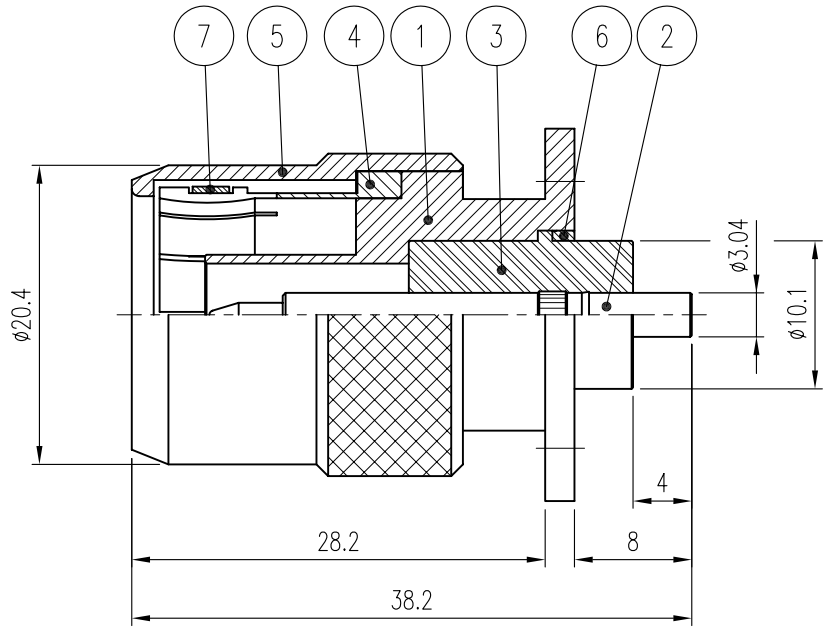
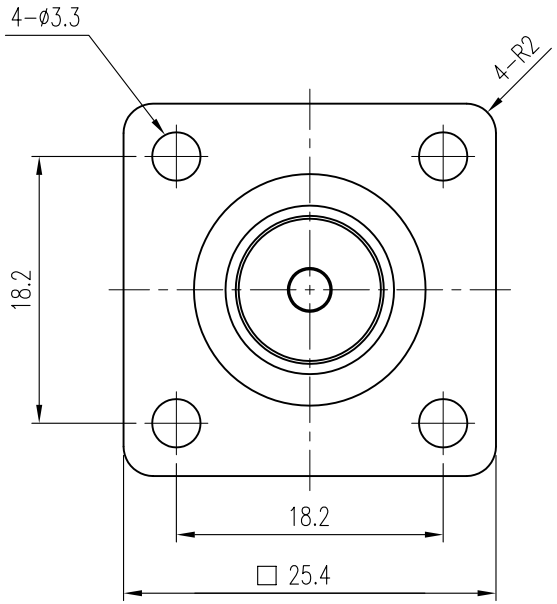
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00023-5/1
6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00033-5/1
5	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00057-5/1
4	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00053-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01270-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01494-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01959-5/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2008. 4. 15.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 2/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N50-P-H4-R PUSH

A4

도번 CN01979-7/1